

#### 7-4-11 座繰り部糊付着／沉孔的胶迹／ Paste on counterbored area

【特徴】座繰り部や他の樹脂部にテープ糊が付着している状態の欠陥

【特征】在沉孔及其树脂部附着胶带的胶迹的缺陷。

【Characteristics】Tape adhesive is adhered to the base of a counterbored area.

【原因・判断ポイント・発生工程】金めっき剥離テープテストなどでのセロテープ糊が付着して出来たもの（試験工程）

【原因、判断要点、发生工序】在镀金层进行胶带剥离试验等时，附着透明胶带的胶所引起的（试验工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by an adhered cellophane tape adhesive left after peel test for gold plating adhesion (Testing)



【コメント】  
顕微鏡倍率× 33

【注釋】  
显微镜倍率 × 33

【Comments】  
Magnification: ×33



【コメント】  
顕微鏡倍率× 100

【注釋】  
显微镜倍率 × 100

【Comments】  
Magnification: ×100

#### 7-4-12 金端子部打痕／镀金插脚的压痕／ Dent on gold plated edge board contact

【特徴】金端子部に打痕が存在する状態の欠陥

【特征】镀金插脚上有压痕的缺陷。

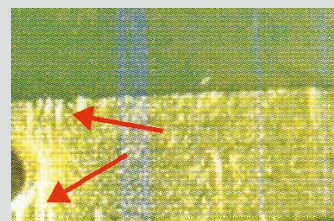
【Characteristics】A gold plated edge board contact is dented.

【原因・判断ポイント・発生工程】プレス打抜き加工時に介在した異物、基板積重ね時に挟まった異物などにより出来たもの（打抜きプレス工程、搬送、マテハン工程）

【原因、判断要点、发生工序】在冲切时夹杂杂物、或者板堆垛时夹着杂物等所引起的（冲切工序、搬运工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

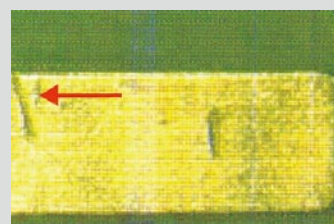
The defect is caused by a foreign object lying between board and die in punching or between stacked boards (Punching process, transporting and material handling)



【コメント】  
顕微鏡倍率×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×